



中华人民共和国国家标准

GB/T 6346.2601—2018/IEC 60384-26-1:2010

电子设备用固定电容器 第 26-1 部分：空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—Part 26-1: Blank detail specification—Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte—Assessment level EZ

(IEC 60384-26-1:2010, IDT)

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
1 一般数据	2
1.1 推荐的安装方法(应加以说明)	2
1.2 尺寸	2
1.3 额定值和特性	3
1.4 规范性引用文件	3
1.5 标志	3
1.6 订货资料	4
1.7 放行批证明记录	4
1.8 附加内容(不作检验用)	4
1.9 补充或提高总规范和(或)分规范中所规定的严酷等级或要求	4
2 检验要求	4
2.1 程序	4
参考文献	11
表 1 外壳代号和尺寸	2
表 2 与外壳号有关的电容量值和电压值	3
表 3 特性	3
表 4 其他要求(其他特性)	4
表 5 质量一致性检验试验一览表	5

前 言

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(IEC 60384-1:2008)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装(MnO₂)固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.3—2015/IEC 60384-3:2006)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装(MnO₂)固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2006)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998, 第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4-1:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体电解质(MnO₂)铝电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-4-2:2007)；
- 第 5 部分：分规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和一般要求(GB/T 6261—1998/IEC 60384-5:1993)；
- 第 5-1 部分：空白详细规范 额定电压不超过 3 000 伏的直流云母介质固定电容器试验方法的选择和一般要求 评定水平 E(GB/T 6262—1998/IEC 60384-5-1:1993)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用)(GB/T 14004—1992/IEC 60384-6:1987)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 14005—1992/IEC 60384-6-1:1987)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2011/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(GB/T 6346.11—2015/IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.1101—2015/IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 12 部分：分规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-12:1988)；

- 第 12-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-12-1:1988);
- 第 13 部分:分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10188—2013/IEC 60384-13:2006);
- 第 13-1 部分:空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006);
- 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 6346.14—2015/IEC 60384-14:2005);
- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 6346.1401—2015/IEC 60384-14-1:2005);
- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982, 第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
- 第 15-1 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(可供认证用) (GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用) (GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用) (GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1992);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器评定水平 E 和 EZ (GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 固体(MnO₂)和非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E (GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 (GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2005);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2006);
- 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ

- (GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004);
- 第 23 部分:分规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-23:2015);
 - 第 23-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚萘二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-23-1:2015);
 - 第 24 部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-24:2015);
 - 第 24-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-24-1:2006);
 - 第 25 部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器(GB/T 6346.25—2018/IEC 60384-25:2015);
 - 第 25-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 6346.2501—2018/IEC 60384-25-1:2006);
 - 第 26 部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器(GB/T 6346.26—2018/IEC 60384-26:2010);
 - 第 26-1 部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 6346.2601—2018/IEC 60384-26-1:2010)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 26-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-26-1:2010《电子设备用固定电容器 第 26-1 部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

- GB/T 2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 T:锡焊 (IEC 60068-2-20:1979,IDT)
- GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范(IEC 60384-1:1999,IDT)

本部分做了下列编辑性修改:

- 修正与上层标准 IEC 60384-26:2010 不一致的地方。表 5 中“C3 分组”的“ p ”的值“6”更正为“3”,“ n ”的值“24”更正为“36”。表 5 中“C4 分组”的“ p ”的值“12”更正为“6”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位:南通江海电容器股份有限公司。

本部分主要起草人:黄玉明、姚建军、韩红军。

电子设备用固定电容器
第 26-1 部分:空白详细规范
导电高分子固体电解质铝固定电容器
评定水平 EZ

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充文件,它包括对详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合 IEC 要求的详细规范。

在制定详细规范时应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号内数字标注的位置上应填写下列内容:

详细规范的识别:

- [1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- [2] IEC 或国家标准的详细规范编号、出版日期以及国家标准体系要求的任何其他的内容。
- [3] IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- [4] IEC 或国家标准的空白详细规范。

电容器的识别:

- [5] 电容器类型的简要说明。
 - [6] 典型结构的简述(当适用时)。
 - [7] 标有对互换性有重要影响的主要尺寸的外形图和(或)引用国家或国际的外形方面的文件。
- 另一种方法可在详细规范的附录中给出这种图形。

- [8] 用途或用途组别和(或)评定水平。
- [9] 最重要特性的参考数据,以便各种不同类型电容器之间进行比较。